

지원서 작성·면접 시 블라인드 가이드라인

(1) 개인 신상정보

- 성명, 생년월일, 신체조건, 주소, 출신지, 가족관계, 출신학교 등 **언급 불가**
- 장애·보훈·지역인재 등 우대가점 관련항목은 해당여부만 체크
- 학력수준(대졸, 석사 등) **언급 불가**

<신상정보 처리예시>

- ◆ 연세대학교 → ○○대학교 / 양정고등학교 → ○○고등학교
 - 1) 이메일, 동아리명 등으로 출신학교가 간접적으로 드러나지 않도록 유의
 - 2) 지도교수 등 교수명 **언급 불가**(학교 추측 가능), 프로젝트명 **언급 가능**
- ◆ 면접 시 성명, 수험번호 언급 불가 (별도로 주어진 면접번호로 지칭)

(2) 경력 및 경험사항

- 경력사항 : 금전적 보상을 받는 경우(회사 인턴근무 등 근로계약서 체결시)
- 경험사항 : 금전적 보상이 없는 경우(학술연구, 프로젝트, 파트타임, 장학생 등)
- 자사·타사 경력·경험 : 기관명 포함 산업분야, 부서, 직무 등 언급 가능
단, 사업소(지역)명은 **언급 불가**(LG전자 오산공장 -> LG전자 ○○공장)
- 학교 교육 등 경험 사항 : 학교명 **언급 불가**, 블라인드 처리 필수

<경력·경험 처리예시>

- ◆ ○○공사 → 수자원공사 / ○○전자 → LG전자 / 회사명 **언급 가능**
- ◆ ○○은행 → 신한은행, , 금융분야 기업 등 / 회사명 **언급 가능**(본인 선택)
- ◆ 한국대학교 ☆☆프로그램 이수 → ○○대학교 ☆☆프로그램 이수(**학교명 금지**)
- ◆ 한국전력공사 서울본부 강남지사 총무팀 인턴 → 한국전력공사 00지사 총무팀 인턴

(3) 교육 및 자격사항

- 교육사항 : 학교명 외 기관명, 전공, 성적(정량화 점수 반영 없음) 등 **언급 가능**
- 어학·자격사항 : **언급 가능**